

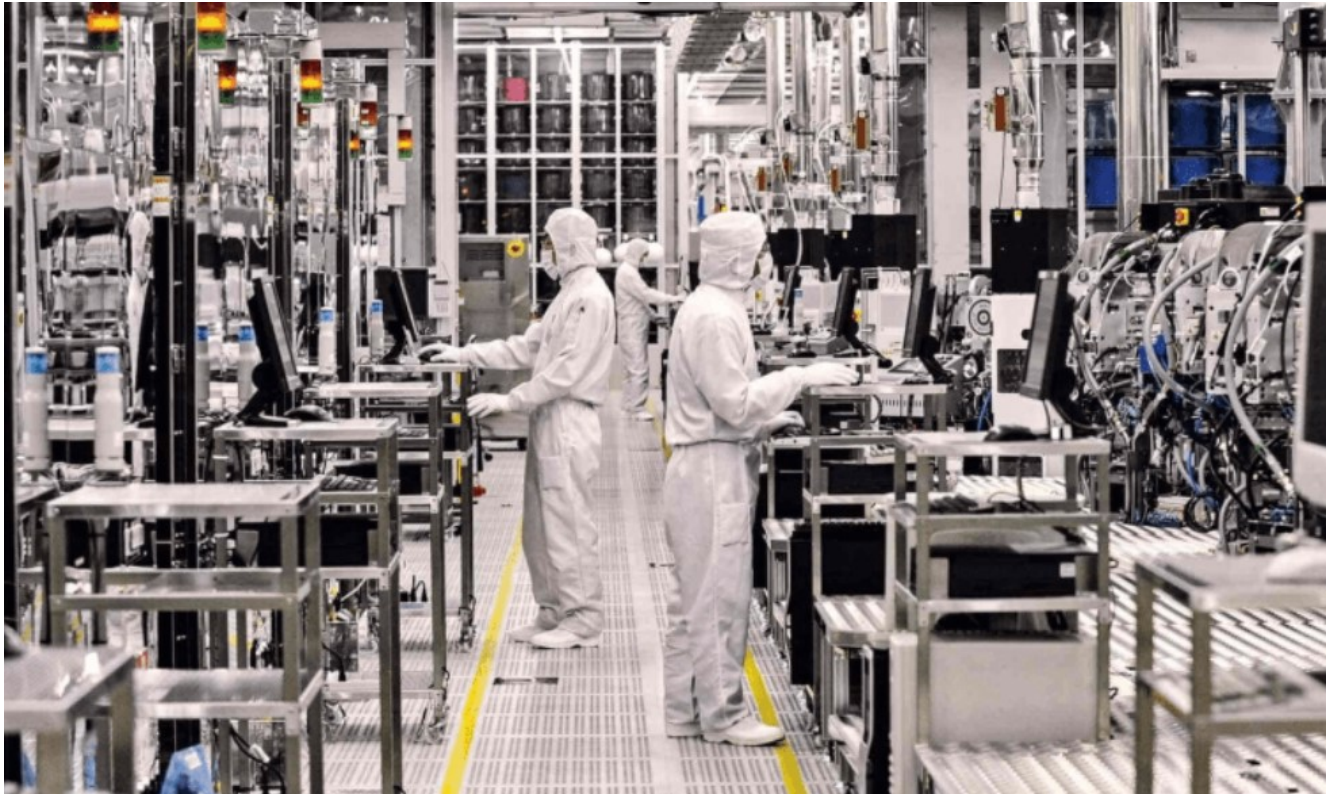
El director de TSMC se burla de las promesas de fundición de Samsung

Los datos de la industria sitúan a TSMC dominando de forma aplastante el 70 % del mercado global de fundición, Samsung se queda con el 7%

El dominio global en la fabricación de semiconductores sigue siendo un terreno de alta tensión. Durante una sesión de preguntas y respuestas con sus accionistas, el CEO de TSMC, C.C. Wei, lanzó una sutil pero contundente indirecta dirigida a Samsung, sugiriendo que la histórica meta de la compañía surcoreana de arrebatarse el liderazgo de las fundiciones sigue estando muy lejos de la realidad.

Treinta años de promesas incumplidas

Sin mencionar directamente el nombre de Samsung por cuestiones de protocolo corporativo, Wei expresó su total confianza en que el control de Taiwán sobre la fabricación de chips por contrato no corre peligro. Para respaldar su postura, ironizó sobre el patrón de declaraciones que su principal competidor ha mantenido durante las últimas décadas.



«Hace veinte años, nuestro competidor dijo que alcanzaría a TSMC en 10 años. Hace diez años, dijeron que se pondrían al día en otros diez años; y recientemente, dijeron una vez más que se pondrían al día en 10 años.»

Las declaraciones del directivo coinciden con una era donde la fiebre por el hardware de Inteligencia Artificial mantiene a las plantas de fundición trabajando a su máxima capacidad. A pesar de que tanto TSMC como Samsung realizan inversiones multimillonarias para liderar la transición hacia los nodos de producción de 2 nanómetros (2nm), la brecha comercial entre ambas firmas se mantiene abismal.

De acuerdo con estimaciones recientes del sector, TSMC controla aproximadamente el 70% del mercado global de fundiciones puras, mientras que Samsung se ubica en una lejana segunda posición con un 7% de la cuota. A pesar de los esfuerzos de Seúl, la firma coreana ha tenido serias dificultades para competir con la escala de producción y la consistencia en los niveles de rendimiento que ofrece el gigante taiwanés.



La IA y el empaquetado CoWoS: el muro insuperable

Una de las razones clave de este monopolio radica en las exigencias de la Inteligencia Artificial. Las empresas tecnológicas que desarrollan aceleradores de IA no solo buscan la mayor densidad de transistores, sino que dependen críticamente de las soluciones de empaquetado avanzado de TSMC, conocidas como CoWoS. Esta tecnología de integración se ha vuelto tan vital como el propio chip para gigantes como NVIDIA, que se encuentran en una carrera acelerada por desplegar hardware cada vez más potente.

A pesar de la crítica a su división de fundición, Wei ablandó sus declaraciones reconociendo el indiscutible liderazgo de Samsung en el sector de las memorias, catalogándola como la fuerza dominante en el desarrollo de Memoria de Alto Ancho de Banda (HBM), uno de los componentes más cruciales dentro de la infraestructura moderna de IA.

Sin embargo, en lo que respecta estrictamente al negocio de fabricar los procesadores de otras empresas, TSMC se beneficia de un ecosistema manufacturero y una confianza de ejecución construida a lo largo de décadas que resultan sumamente difíciles de replicar. Por ahora, el mensaje del CEO de TSMC es claro: fijar plazos en conferencias de prensa es sencillo, pero alcanzarlos en el mundo real es una historia completamente diferente.

Fuente: isamarcial.